

采购需求

一、总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。

1.2 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其投标无效。

1.3 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 中标的主要产品的数量、单价、规格等将予以公布。

二、采购标的的名称及数量

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	全自动匀胶显影系统	套	2	设备主要组成：传片单元、涂胶单元、显影单元、增粘单元及冷热板、互联单元、试剂控制单元、环境控制单元等。

三、技术要求

3.1 标识符号

标识类型	标识符号	标识符号含义
实质性参数	★	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求，视为无效投标
重要参数	●	重要技术指标，根据评分办法中相关要求进行审核
未标记参数		根据评分办法中相关要求进行审核

注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有

子项技术参数或要求方能得分。

3.2 技术要求

3.2.1 传片及互联单元

- (1) ★上片盒站位置数量： ≥ 2 个，晶圆尺寸：12 英寸，晶圆类型包含硅片，蓝宝石片，玻璃片；
- (2) ★通过机械臂实现片盒与工艺腔室及深紫外光刻机的自动传送，支持晶圆厚度涵盖 0.5~1.2mm；
- (3) ★设备支持并实现与 ASML 1400F 深紫外光刻机有效互联；
- (4) 具有晶片自动机械对中功能，对中精度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。

3.2.2 涂胶单元

- (1) ★最高转速： $\geq 6000\text{rpm}$ ；
- (2) 转速精度： $\leq 1.0\text{rpm}@10\sim 6000\text{rpm}$ ；
- (3) ★最大加速度： $\geq 30000\text{rpm/s}$ ，具备正反转功能；
- (4) 胶嘴具有自动清洗及胶嘴保湿功能；光阻回吸检查：无滴液；
- (5) ●光刻胶过滤：100cp 以下胶过滤精度 $\leq 0.05\mu\text{m}$ ，100~200cp 胶过滤精度 $\leq 0.2\mu\text{m}$ ；
- (6) ★涂胶模块 ≥ 5 组，其中至少 2 组为涂胶 (COT) 腔，支持至少 10 路胶，其中支持至少 5 路粘度 $<100\text{cp}$ 的胶路涂胶，支持至少 1 路粘度 $>200\text{cp}$ 的胶路涂胶；至少一组为 Barc 腔，支持至少 3 路胶；至少一组为 Tarc 腔，支持至少 3 路胶；
- (7) 具备边缘清洗 (EBR) 功能及背面清洗 (BSR) 功能；EBR 切边清洗控制精度不超出 $\pm 0.2\text{mm}$
- (8) ●光阻温度控制范围涵盖：18~27℃，控制精度： $\leq 0.1^\circ\text{C}$ 。

3.2.3 显影单元

- (1) ★配置至少 5 个显影单元，具备至少 5 路独立显影液；
- (2) ●显影液温度控制范围涵盖：18~27℃，控制精度： $\leq 0.1^\circ\text{C}$ ；
- (3) 具备自动排气调节；
- (4) 具备显影背洗功能；
- (5) ●显影液过滤精度： $\leq 0.05\mu\text{m}$ ；

- (6) ★CD 2um 显影均匀性 $\leq 5\%$, CD 150nm 显影均匀性 $\leq 5\%$;
- (7) 最高转速: $\geq 5000\text{rpm}$;
- (8) 转速精度 $\leq 1.0\text{rpm}@10\sim 5000\text{rpm}$;
- (9) 配备 WEE 模块, WEE 去边范围 0.1~10mm 可调, 精度 $\leq 0.15\text{mm}$; WEE 光源强度 $\geq 1000\text{ mW/cm}^2$ 。

3.2.4 增粘单元及冷热板

- (1) ●配备至少 2 个 ADH(HMDS) 增粘模块, 温度范围: 涵盖 50~180℃;

增粘热板温控精度:

- 1) 温控精度 $\leq 0.85^\circ\text{C}@50.0\sim 120.0^\circ\text{C}$;
- 2) 温控精度 $\leq 1.25^\circ\text{C}@120.1\sim 150.0^\circ\text{C}$;
- 3) 温控精度 $\leq 1.7^\circ\text{C}@150.1\sim 180.0^\circ\text{C}$ 。

- (2) ●配备至少 4 个低温热板, 温度范围: 涵盖 50~250℃;

低温热板温控精度:

- 1) 温控精度 $\leq 0.5^\circ\text{C}@50.0\sim 120.0^\circ\text{C}$;
- 2) 温控精度 $\leq 0.6^\circ\text{C}@120.1\sim 150.0^\circ\text{C}$;
- 3) 温控精度 $\leq 0.8^\circ\text{C}@150.1\sim 180.0^\circ\text{C}$;
- 4) 温控精度 $\leq 0.9^\circ\text{C}@180.1\sim 200.0^\circ\text{C}$;
- 5) 温控精度 $\leq 1.0^\circ\text{C}@200.1\sim 250.0^\circ\text{C}$ 。

- (3) ●配备至少 2 个高温热板, 温度范围: 涵盖 50~350℃;

高温热板温控精度:

- 1) 温控精度 $\leq 1.5^\circ\text{C}@50.0\sim 120.0^\circ\text{C}$;
- 2) 温控精度 $\leq 2.0^\circ\text{C}@120.1\sim 150.0^\circ\text{C}$;
- 3) 温控精度 $\leq 3.0^\circ\text{C}@150.1\sim 200.0^\circ\text{C}$;
- 4) 温控精度 $\leq 5.0^\circ\text{C}@200.1\sim 250.0^\circ\text{C}$;
- 5) 温控精度 $\leq 7.0^\circ\text{C}@250.1\sim 350.0^\circ\text{C}$ 。

- (4) ●配备至少 4 个高精度热板, 温度范围: 涵盖 50~250℃;

高精度热板温控精度:

- 1) 温控精度 $\leq 0.25^\circ\text{C}@50.0\sim 120.0^\circ\text{C}$;
- 2) 温控精度 $\leq 0.3^\circ\text{C}@120.1\sim 150.0^\circ\text{C}$;

- 3) 温控精度 $\leq 0.35^{\circ}\text{C}@150.1\sim 180.0^{\circ}\text{C}$;
 - 4) 温控精度 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}@180.1\sim 200.0^{\circ}\text{C}$;
 - 5) 温控精度 $\leq 0.6^{\circ}\text{C}@200.1\sim 250.0^{\circ}\text{C}$ 。
- (5) ● 配备至少 4 个冷板，温度范围涵盖 $15\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，温控精度 $\leq 0.4^{\circ}\text{C}$ 。

3.2.5 控制系统:

- (1) 具备人机界面的多分布式控制系统，能够实现工艺过程的全自动控制;
- (2) 控制系统应能检测相关部件的运行状态，具有自我故障诊断功能;
- (3) 具有所有用户活动的日志文件保存功能; 操作记录、工艺记录和报警记录;
- (4) 支持 SEMI: SECS/GEM 标准通讯协议; 支持天车系统和 CIM 系统;
- (5) 设备专用软件终身免费使用，配备双硬盘，支持数据实时备份;
- (6) 设备内部温度控制精度: $\leq 0.1^{\circ}\text{C}@22^{\circ}\text{C}$ 。

3.2.6 工艺指标要求:

- (1) ★涂胶均匀性: 旋涂 $0.5\sim 1\mu\text{m}$ 厚的光阻时，厚度均匀性片内 $3\sigma \leq 2\%$ ，片间 $3\sigma \leq 2\%$;
- (2) 测试条件: 每个 wafer 上测试 49 个点，每天做 5 片，连续 5 天进行片内、片间均匀性测量;
- (3) ★显影均匀性: 关键尺寸 $\text{CD}=150\text{nm}$ 时，线宽精度: 片内 $\leq 5\%$ (3σ)，片间 $\leq 5\%$ (3σ)，批次间 $\leq 5\%$ (3σ);
- (4) 测试条件: 每个 wafer 上测试 49 个点，每天做 5 片，连续 5 天进行片内、片间均匀性测量;
- (5) ●颗粒度控制标准; Dry run 颗粒度 $\leq 10\text{ea}@0.1\mu\text{m}$ ，Wet run 颗粒度 $\leq 20\text{ea}@0.1\mu\text{m}$ 。

3.2.7 设备可靠性性能要求:

- (1) WPH (每小时晶圆产量) ≥ 120 片;
- (2) 设备 uptime $\geq 95\%$;
- (3) 设备稳定性: 连续传片 3000 片无异常。

四. 其他要求

1.项目交付进度及其他

交付时间：合同签订之日起15个月内完成生产并具备发货条件，接采购人通知后方可发货，接采购人通知之日起6个月内完成到货、安装调试并具备验收条件。

交付地点：采购人指定地点

2.其他事项

如供应商原因导致交付进度延期，采购人驻厂费用由供应商承担，包括但不限于交通、食宿等费用。

3.验收

3.1本项目验收分为【初步验收】和【最终验收】两个阶段。

(1) 初步验收

(a) 检查货物的内外包装是否完好，安全标志完好正常；货物及其附件是否齐全，外表是否有残损、锈蚀、碰伤等。检查设备和所附配件的型号、编号核对是否无误。

(b) 安装并调试完成后，供应商应按照技术协议相关条款对各项性能指标进行测试。测试应在双方技术人员共同见证下进行。

(c) 性能测试的所有技术性能参数必须全部合格，方可视为通过初步验收。供应商出具《初步验收报告》，采购人确认后有效。

(2) 最终验收

(a) 初步验收通过后，设备进入为期【90】天的试运行期。

(b) 试运行期届满且满足技术协议所有条件后，视为设备通过最终验收，双方签署《最终验收报告》。

3.2其他验收要求

(1) 采购人负责保障合同设备验收期间所需的工艺条件，并及时配合供应商进行合同设备现场验收。供应商应在确认设备发货日期前 30 日到采购人设备安装地点确认设备所需场地和设备所需工艺条件。在确保设备场地和工艺条件符合设备要求的前提下，再确定发货日期进行发货。采购人提出因场地受限无法接收货物的，从供应商发出交货通知至采购人场地受限解除的时间不计算入交货期

内；

(2) 在安装及调试过程中，采购人相关人员仅负责厂务条件的配合，未经培训并签署验收报告之前，采购人的所有操作均应在供应商指导下完成，不得擅自操作，因供应商技术指导错误导致的一切损失(包括对采购人厂务设施的破坏)，均应由供应商负责；

(3) 由于采购人的验收过程必须对货物进行使用 and 检查，因此供应商对采购人的验收行为予以免责，但故意的人为物理损坏除外。

(4) 采购人对货物的验收、认可，不免除供应商对货物质量缺陷应承担的责任。

(5) 双方对责任归属有争议的，采购人有权以有资质的检测机构的检测报告为归责依据。鉴于采购人为急于取得货物并有效使用的弱势方，该检测的费用由供应商支付。若最终确认为采购人责任，供应商可向采购人追偿该检测费用。

(6) 如供应商提供的货物验收结果为不合格，采购人有权单方面解除合同，供应商应在接到采购人通知后 15 天内将产品撤出现场，退还采购人已支付的全部款项，并承担由此并给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人重新采购差价损失、工期损失、采购人对第三方的违约损失、采购人维权发生的诉讼费、律师费、交通费等。

4.培训

供应商须为采购人相关人员提供以下免费培训，以确保采购人独立掌握设备的使用功能，培训完成后提供完整电子版手册，包括但不限于设备操作手册，设备维护手册，其他附件的使用说明。

- (1) 操作系统备份、专用软件覆盖安装，数据读取与传输；
- (2) 设备工作原理、正确操作步骤、方法；
- (3) 程序编写、调用、关键参数设置范围及相互间影响；
- (4) 设备常见故障分析、判断、处理，正确保养流程、标准、周期；
- (5) 设备安装、调试后，设备供应商负责免费培训 1-3 名采购人相关人员；
- (6) 培训须保证每个人具备独立操作的能力，培训期不少于 3 个工作日。

5. 设备保修及售后服务

5.1 免费保修期：供应商对其所提供产品提供不少于 24 个月的免费保修期，

免费保修期从全部产品验收合格之日起算。供应商须在仪器设备故障报修通知 24 小时内做出响应；常规问题在 48 小时内解决；较大问题应在 3 天内解决或提出明确的解决方案，经采购人认可后，在预定期限内解决问题。否则，供应商应赔偿由此造成的损失（包括但不限于采购人重新采购差价损失、工期损失、采购人对第三方的违约损失、采购人维权发生的诉讼费、律师费、交通费等）。

保修期满前 1 个月供应商负责一次免费全面检查，出具正式报告，并负责解决存在的问题；

5.2 更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修，若维修部件自修复之日起距整机免费保修期结束不足3个月，维修时所更换部件的保修期限延长至修复之日起3个月止；

5.3 若供应商未按约定时间执行或提供相应的质量保证期内的服务，由此给采购人造成的全部损失，包括采购人委托第三方提供服务、维修或重新更换有关产品等支出的费用，由供应商承担，采购人有权从未支付款项中优先扣除，不足部分采购人保留索赔的权利；

5.4 保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间从保修期中扣除。保修期内每出现一次设备连续宕机超过7天或者设备宕机时间超过24小时的故障间隔小于等于15天的情况，保修期延长30天。保修期内设备无故障运行时间（uptime）未达技术指标要求的（技术指标未提及的按95%为标准（正常例行维护时间不计），每两个月统计一次，计算到小数点后一位），以违约5%为一个单位，每一个单位保修期延长30天。保修期内设备备件到达采购人设备现场的时间每超过72小时（节假日96小时），保修期延长30天。如发生保修期延长情况，则在所延长的保修期内含人工和备件；

5.5 保修期满后，供应商承担合同设备的终身有偿维修责任，由供应商专业工程师提供终身维修，不定期随访，并为采购人提供终身有偿技术支持。供应商应长期为采购人优惠（折扣）供应零部件，并协助采购人维护保养所供产品。保修期外，无论任何原因的造成的设备故障，供应商应及时提供设备有偿技术支持，并在接受到采购人的设备故障通知后8小时内做出反应；

5.6 供应商保证本合同设备可以安全使用。供应商应保证保修期以及保修期之后设备的零部件的维修和供应，并协助采购人维护保养所供产品。设备的零部

件可以是原厂的或者质量、规格、性能完全符合规定的替代品。

6.档案文件要求

供应商负责收集整理合同形成和实施过程中产生的各种载体和形式的文件材料，并严格按照采购人要求提供归档材料。归档材料质量应符合采购人制度规范要求和方法，确保档案完整、准确、系统。